

广东省经济和信息化委员会

粤经信电软函〔2017〕97号

广东省经济和信息化委关于组织开展 “芯火”双创基地（平台）建设工作的通知

各地级以上市经济和信息化主管部门，顺德区经济和科技促进局：

根据工业和信息化部《关于组织开展“芯火”双创基地（平台）建设工作的通知》（工电子函〔2017〕361号）要求，请你们认真学习，做好“芯火”双创基地（平台）建设工作。请各地市经济和信息化主管部门组织辖区内相关产业化基地根据要求准备相关材料并进行审核，于8月15日前书面送我委（电子软件处）。

附件：工业和信息化部关于组织开展“芯火”双创基地（平台）建设工作的通知（工电子函〔2017〕361号）



（联系人：平婧，电话：020-83134285）

中华人民共和国工业和信息化部

工电子函〔2017〕361号

工业和信息化部电子信息司关于组织开展“芯火” 双创基地（平台）建设工作的通知

各有关省、直辖市和计划单列市工业和信息化主管部门：

为贯彻落实习近平总书记关于网络信息技术与产业发展的系列重要讲话精神以及国务院大力推进“大众创新、万众创业”的战略部署，抓住中国制造2025、“互联网+”、《国家集成电路产业发展推进纲要》等国家战略实施机遇期，我部正在抓紧组织实施“芯火”创新行动，旨在集聚公共服务机构、优势骨干企业、社会力量等资源，以集成电路技术和产品为着力点，发展和打造一批信息技术领域新型双创基地（平台）（以下简称芯火双创基地（平台）），为小微企业、初创企业和创业团队建立完善的政策、制度环境和服务体系，推动形成“芯片—软件—整机—系统—信息服务”的产业生态体系。现将芯火双创基地（平台）建设的有关工作要求通知如下：

一、总体要求

把握信息技术产业发展和变革趋势，强化创新驱动发展

战略，依托国家集成电路设计产业化基地、新型工业化产业示范基地等相关产业化基地，集聚国内外优势企业、高校和科研院所等各方力量，发展和打造一批芯火双创基地（平台），推动产业集聚区公共服务机构能力升级，引导创新资源集聚，提供创新研发环境；依托优秀企业家及技术团队，提供创新创业辅导，加快创业者培育；面向“互联网+”、中国制造 2025、两化深度融合等重点领域，推动创新成果推广应用，支撑科研成果产业化；建立技术链、资金链、产业链协同机制，加快创新企业孵化，完善企业公共服务体系，营造创新创业的氛围。

二、建设目标

（一）提升和完善现有产业化基地服务能力和水平，打造支撑信息技术领域双创工作的平台；

（二）推动集成电路技术创新成果转化及推广应用；

（三）以整机系统需求为牵引，加强软硬协同，支持下游企业采用基地（平台）内企业研发的芯片，围绕基地（平台）建设打造生态体系；

（四）带动人才培养培训，形成企业孵化能力。

三、重点方向

把握后摩尔时代核心信息技术加速融合创新的趋势，结合当前应用热点和产业急需，依托有条件的产业化基地，重点打造以下几类平台：

（一）智能硬件平台。面向新兴互联网终端发展需求，发挥下游企业应用需求优势，集聚国内外芯片企业的软硬件开发环境和技术支持等优质资源，支持可穿戴设备、北斗、虚拟/增强现实、安防、医疗、人工智能等领域核心芯片、配套芯片、软件算法、终端产品的开发及应用推广，培育中国特色的技术应用生态体系。

（二）智能传感平台。整合利用相关传感器设计与研究企业、机构的力量，提升研发设计、中试公共服务平台承载能力，建立模块化工艺库，完善测试方式和测试标准，重点围绕图像传感器、惯性组合传感器、生物医药/化学传感器等中高端传感器，开展产品性能、软件算法、网络系统、规模化生产等共性技术的研发和产业化。联合各地物联网产业联盟，进行传感器产品、解决方案的推广和示范应用。

（三）智慧家庭平台。与国内骨干家电企业合作，开发智能家电用关键芯片、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）等功率器件并推广应用；以提升用户体验为导向，围绕多媒体、影音娱乐、游戏、健康、养老等领域进行产品开发和销售，推动用户端的服务消费。联合整机厂商、电信运营商、电商，推广智慧家庭（智能家电）产品 and 应用方案，带动国内消费市场升级换代。

（四）汽车电子平台。与国内外汽车电子芯片企业以及汽车厂商合作，开发车身控制、故障诊断、自动驾驶、信息

娱乐、导航定位等汽车电子相关应用和产品，优化工业设计，实现功能扩展和创新设计。开发车联网相关产品和服务，结合移动互联网、大数据、云计算等新一代信息技术，促进汽车行业转型升级。

（五）工业互联网平台。与国内外工业芯片企业开展合作，针对传统制造业，开展工业微控制器（MCU）、模拟器件、智能工厂网络芯片及架构的创新，研发控制器、执行器、机器人、机器视觉及工业生产线零部件等相关配套产品，以及流程管理、物料管理、质量和良率提升等配套软件产品，联合系统集成商，实现传统工业基地的智能化改造。

四、实施安排

（一）运行机制

坚持政府引导、市场主体的原则，在工业和信息化主管部门指导下，相关产业化基地、骨干芯片企业 and 应用企业、高校和科研院所紧密配合，共同推动芯火双创基地（平台）建设。其中，工业和信息化部负责加强顶层设计，引导各方资源集聚，营造政策环境。地方工业和信息化主管部门指导和支持本地产业化基地做好平台建设和运营。产业化基地是实施主体，负责平台的搭建和运营，并为双创企业和团队提供办公场地、工商注册、税费减免、MPW（多项目晶圆）等基础服务。骨干芯片企业向创业者开放芯片设计环境，同时为产业化基地配备创业导师团队，鼓励经验丰富的员工进行

二次创业；骨干应用企业向创业者提供芯片应用需求、应用测试验证指导，并开放整机测试验证环境。

（二）组织方式

芯火双创基地（平台）建设采取申报制，由省级（包括省、自治区、直辖市和计划单列市）工业和信息化主管部门组织相关产业化基地，提出芯火双创基地（平台）的建设方案，并报送工业和信息化部。工业和信息化部组织专家对方案进行评审，申报单位根据评审意见完善方案后启动实施。在平台建设和运营过程中将进行阶段性评估。

五、申报条件和要求

（一）申报条件

芯火双创基地（平台）建设所依托的产业化基地应主要面向电子信息和集成电路领域，具有创新意识强烈、发展特色鲜明、竞争优势突出、对上下游产业的带动和统筹整合能力较强、示范效果显著等特点。基地（平台）的运营主体须为具有完善组织管理体系的独立法人单位，财务管理制度健全，产权清晰，拥有固定的场地及 EDA 开发环境，自身具备一定的技术力量和服务能力，有较好的发展潜力，愿意长期稳定地为企业提供服务。

（二）申报要求

1. 各地工业和信息化主管部门结合当地实际和产业发展需求，组织符合条件的产业化基地联合各方力量开展芯火

双创基地（平台）的申报和建设工作的；

2. 申报单位按照要求编制《芯火创新基地（平台）建设工作方案》，并提供相关证明材料（编制提纲及证明材料要求详见附件）。

3. 各地工业和信息化主管部门对申报材料严格把关，于2017年8月31日前，正式发函将相关材料（纸质版及电子版光盘）寄送我司（北京市海淀区万寿路27号院8号楼）。

六、联系人及电话

郝立超 郭力力：010-68208256/010-68208297

特此通知。

附件：《芯火双创基地（平台）建设工作方案》编制提纲



附件

芯火双创基地（平台）建设工作方案编制提纲

编制说明：

一、各申报单位在编制方案时应充分结合本地区整机应用需求，突出区域特色和行业特点；围绕建设主体探索提出创新的服务模式和业务形态。

二、建设方案中若包含多个面向不同领域和应用的平台，请分别详细列出各个平台的建设内容和计划。

三、编制建设方案时应参照本提纲的内容结构和文字格式，可根据实际情况予以扩充或适当调整。

四、请提供申报单位的相关证明材料，包括设立产业化基地及管理机构的批件，单位营业执照、组织结构代码证，已入驻的企业目录以及龙头企业基本情况，证明其服务能力的相关材料等。证明材料为复印件的，均须加盖单位公章。

五、上述材料采用标准 A4 纸张双面印刷，左边装订成册。材料各部分之间应有明显的分隔标识，并与目录、页码相符。

六、报送材料要求纸质件 3 份（其中盖章原件 1 份、复印件 2 份）、电子版 1 份。电子版用 PDF 格式存储，用光盘报送。

芯火双创基地（平台）建设工作方案

组织单位：××省（市）经济和信息化委员会（盖章）

申报单位（运营主体）：××公司（盖章）

填报日期：2017年×月×日

目 录

第一部分 本地区产业资源情况	4
1.1 电子信息制造业基本情况	4
1.2 集成电路产业发展情况	4
1.3 集成电路设计业发展情况	4
1.4 已有产业化基地（平台）基本情况	4
第二部分 芯火双创基地（平台）建设思路	5
2.1 必要性	5
2.2 基本思路	5
2.3 发展目标	5
2.4 创新模式	5
第三部分 芯火双创基地（平台）建设内容	5
3.1 市场分析与平台定位	5
3.2 建设计划	5
3.3 公共服务内容及创新点	6
3.4 生态链构建计划	6
3.5 产学研合作计划	6
第四部分 运营主体与经营情况	6
4.1 运营主体基本情况	6
4.2 现有基础条件	6
4.3 经营情况	7
4.4 主要业务及典型案例	7
第五部分 投资计划及效益分析	8
5.1 未来三年投资计划	8
5.2 资金筹集方案	8
5.3 经济效益及社会效益分析	8
5.4 风险分析	8
第六部分 本地区对基地（平台）的支持措施	8
6.1 发展规划及政策支持	8
6.2 资金支持	9
6.3 其他支持	9
附件：相关证明材料	9

第一部分 本地区产业资源情况

1.1 电子信息制造业基本情况

本地区电子信息制造业基本情况，包括整体规模、技术能力、典型产品等；重点介绍本地区骨干整机厂商的芯片需求情况、企业发展方向等。

1.2 集成电路产业发展情况

本地区集成电路产业整体情况和发展特点、发展战略，以及产业链上下游协同情况等。

1.3 集成电路设计业发展情况

本地区集成电路设计业的现有基础、发展优势、产业布局，以及骨干企业发展情况等。

1.4 已有产业化基地（平台）基本情况

本地区面向集成电路产业提供公共服务的基地（平台）的基本情况，包括但不限于下表内容：

基地（平台）名称	运营主体名称	所有制性质及股东情况	主要业务类型/服务内容	服务场地面积	服务企业数量
平台 1					
平台 2					
.....					

第二部分 芯火双创基地（平台）建设思路

2.1 必要性

本地区建设芯火双创（基地）平台的必要性，亟需通过建设芯火双创（基地）平台解决当前存在的哪些问题，重点扶持哪些产业和领域的发展。

2.2 基本思路

建设芯火双创（基地）平台的基本思路。

2.3 发展目标

芯火双创（基地）平台的发展目标，包括服务企业、带动产业发展、生态建设、培养培训人才、孵化企业等目标。

2.4 创新模式

拟建设的基地（平台）与已有公共服务平台不同的服务模式 and 方式。

第三部分 芯火双创基地（平台）建设内容

3.1 市场分析与平台定位

本地区集成电路领域创新创业发展趋势，以及对公共服务机构的需求。

基地（平台）定位，包括：主要面向领域、发展方向、服务内容、服务辐射区域，以及与其他同类平台的差异等。

3.2 建设计划

项目建设期限，总体建设计划及考核指标，分年度建设

计划及考核指标。

详细描述基地（平台）的具体建设方案，包括软硬件购置、场地和环境条件建设、技术开发、推广方案等。

3.3 公共服务内容及创新点

基地（平台）拟为创新创业提供的服务内容和能力，重点介绍具有创新点的服务内容。

3.4 生态链构建计划

目前已获得开发工具、操作系统、数据库、中间件、办公软件、整机厂商和集成商的支持情况（主要厂商、产品列表及支持方式），以及下一步加强生态链建设的具体计划。

3.5 产学研合作计划

基地（平台）与本地区或其他地区高校、科研院所的合作情况，以及下一步加强产学研合作的具体计划。

第四部分 运营主体与经营情况

4.1 运营主体基本情况

基地（平台）运营主体的基本情况。

股权结构图、股东（主要出资方）情况等。

单位组织结构、管理制度等。

运营主体主要负责人基本情况及从业经历；运营及技术团队主要成员从业经历及业绩。

4.2 现有基础条件

拥有的软硬件设施（包括 EDA 工具、芯片设计和测试环境等）、办公场地、技术服务能力等。

目前主要合作伙伴（代工厂、封装厂、软件厂商、整机厂商、系统集成商等）的技术服务能力情况，及其以往对平台的支持情况。

曾获得由各级政府部门授予资质的情况；曾承担国家和地方项目情况。

4.3 经营情况

可参考下表填报：

经营指标	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 (预计)
营业收入（万元）				
营业成本（万元）				
服务企业数量				
培训人才数量				
带动产值（亿元）				
其他指标（可自行 列举）				

如有其他财务情况，请一并说明，例如无形资产及土地、房产情况；抵押、对外担保情况以及其他事项等。

4.4 主要业务及典型案例

介绍目前开展的主要业务和服务内容。

列举到 2016 年底，最能体现服务重点的典型案例 1 项、服务市场销售额最大的产品 1 项（若二者重合可仅列 1 项），包括但不限于以下内容：

服务企业 1:

服务内容:

主要产品及产量:

技术水平和市场占有率:

第五部分 投资计划及效益分析

5.1 未来三年投资计划

根据基地（平台）建设内容，编制未来三年投资计划，测算总投资需求以及分年度需求。

5.2 资金筹集方案

编制资金筹集方案，并说明各渠道资金目前落实进展情况。

5.3 经济效益及社会效益分析

基地（平台）建成后的经营情况预测，对投资回收期、投资收益率、盈亏平衡点等方面进行分析。

测算基地（平台）投入运营后的经济效益和社会效益。

5.4 风险分析

从政策、市场、技术、运营、财务等方面进行风险分析。

第六部分 本地区对基地（平台）的支持措施

6.1 发展规划及政策支持

本地区支持集成电路产业发展以及双创工作的发展规划。

本地区各级政府对基地（平台）建设的相关政策支持，包

括财税、土地、办公场所等优惠政策。

6.2 资金支持

本地区各级政府对基地（平台）建设和运营可能给予的资金项目支持。

6.3 其他支持

本地区各级政府对基地（平台）建设的其他相关支持。

附件：相关证明材料

设立产业化基地及管理机构的批件

申报单位的营业执照、组织机构代码证

已入驻的企业目录以及龙头企业基本情况

证明申报单位服务能力的相关材料

其他相关材料

公开方式：不公开